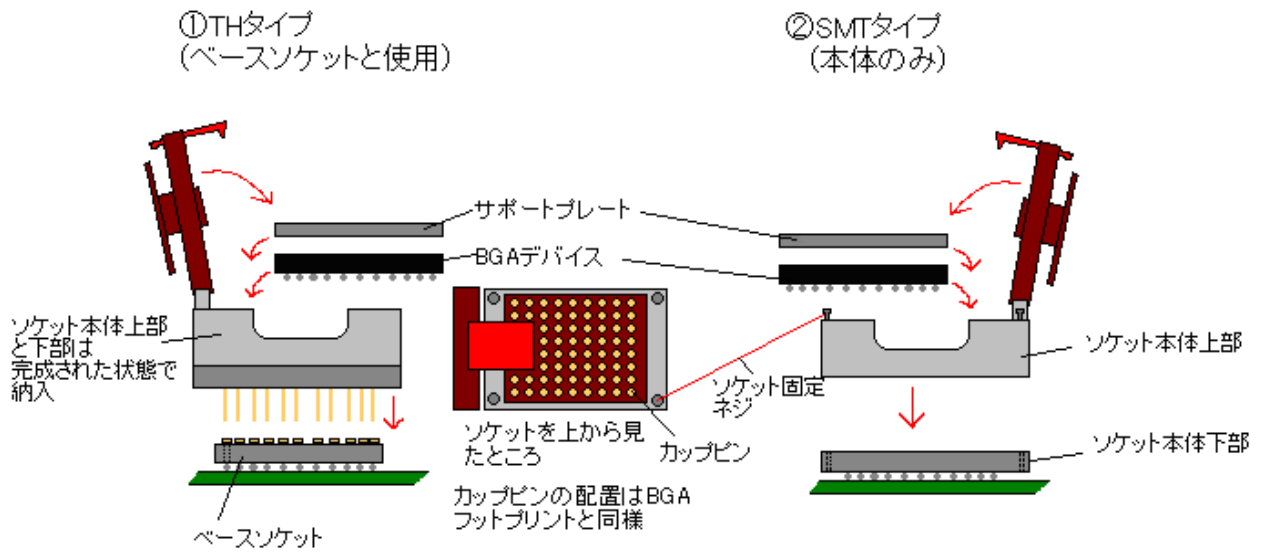
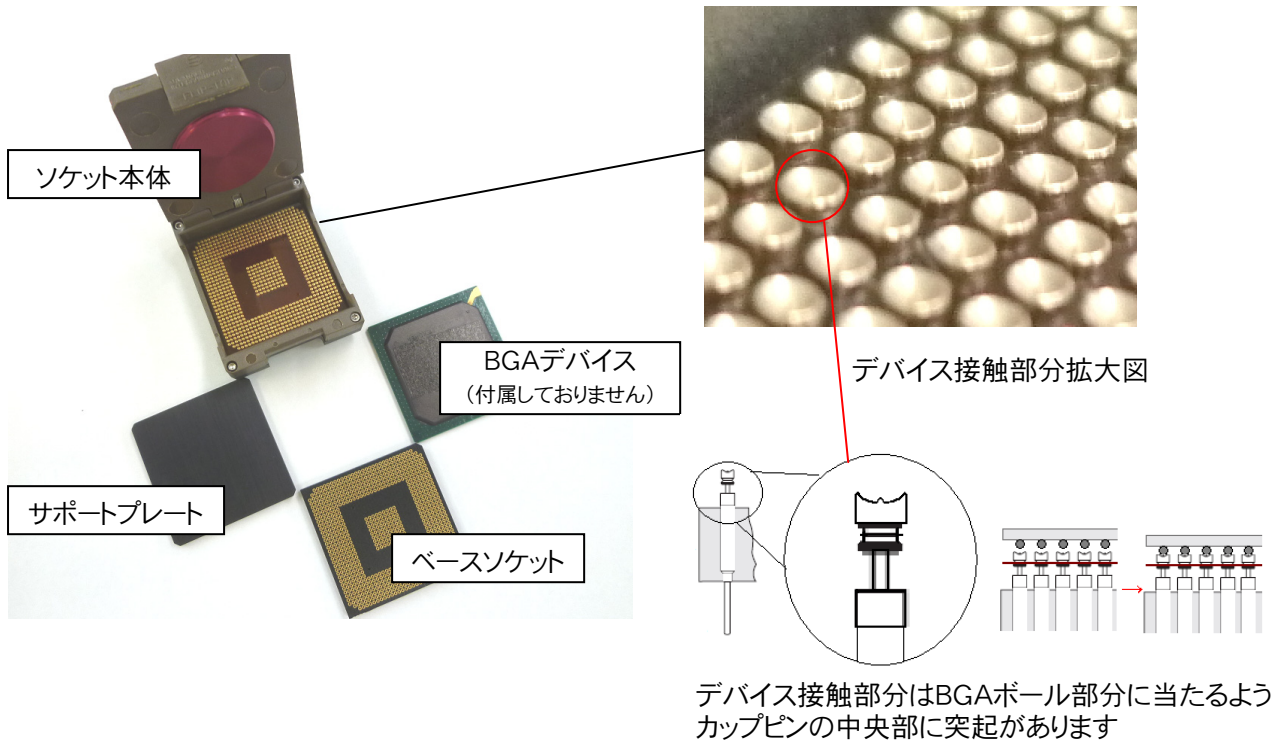


アドバンスト社製 **Flip Top BGA** ソケット構造説明

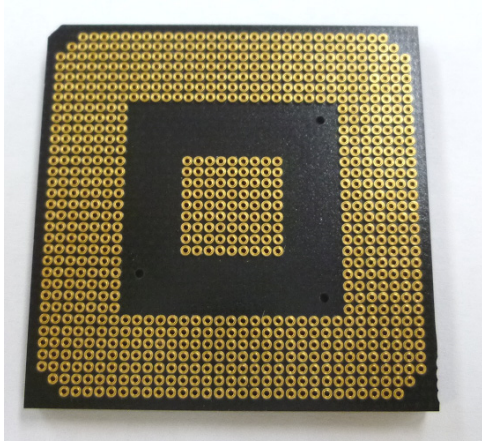
<p>①スルーホール(TH)タイプ</p> <p>BGAデバイスと同サイズのベースソケットを基板へ実装し、そこへソケット本体を差し込み使用します。 高さを出すことにより周辺デバイスに干渉せずソケットを使用することが可能です。</p>	<p>②表面実装(SMT)タイプ</p> <p>ソケット本体下部をそのまま基板に実装して使用します。</p>
--	--



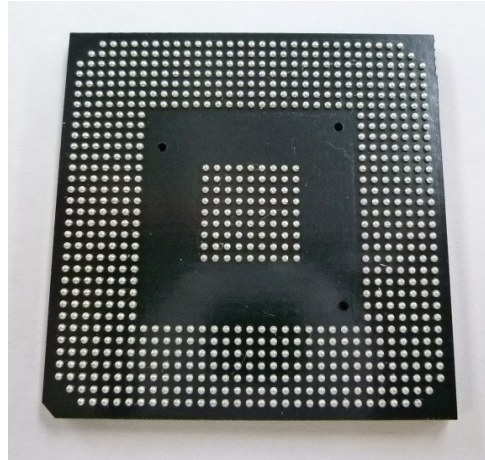
スルーホールタイプ



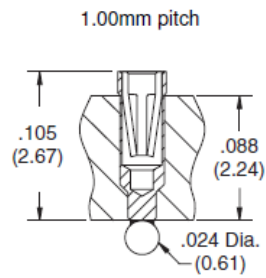
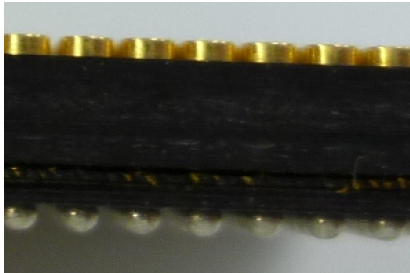
ベースソケット(ソケット本体側)



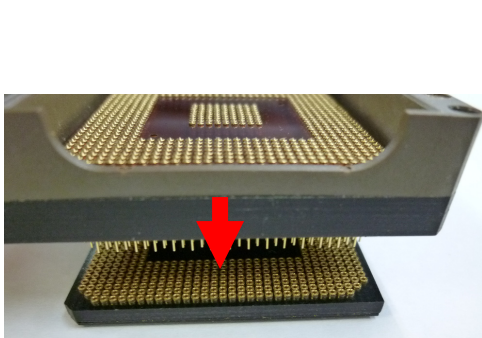
(基板側)



ベースソケット側面



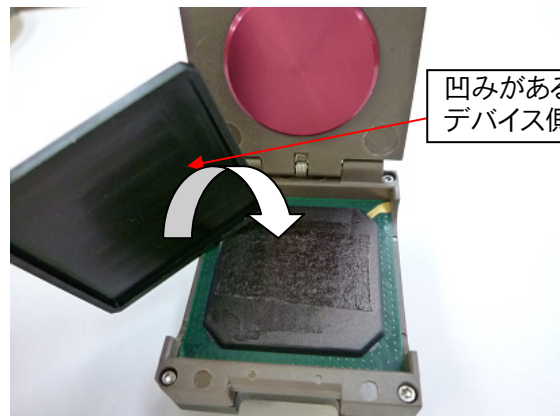
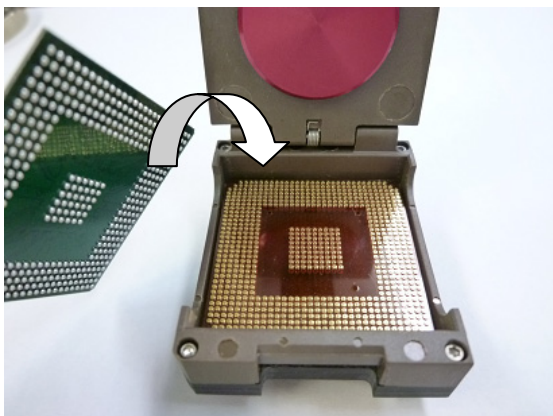
ベースソケットを基板に実装し、本体を差し込みます。



BGAデバイスを入れます

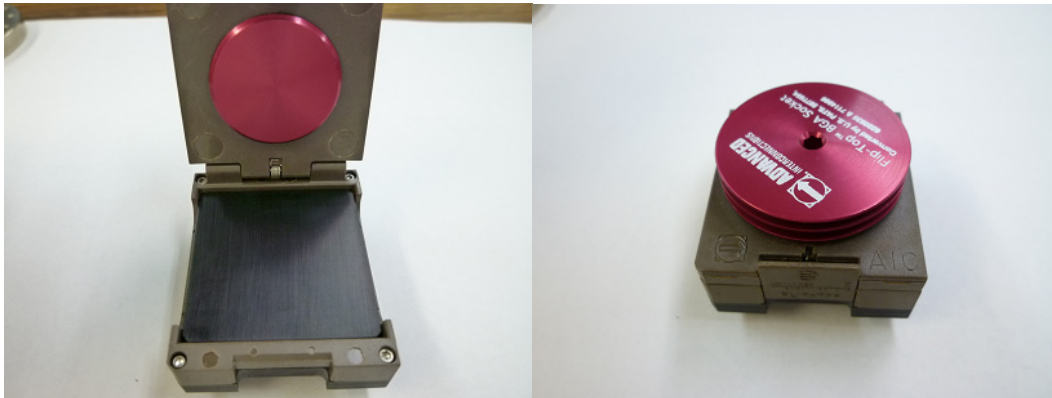


サポートプレートを入れます

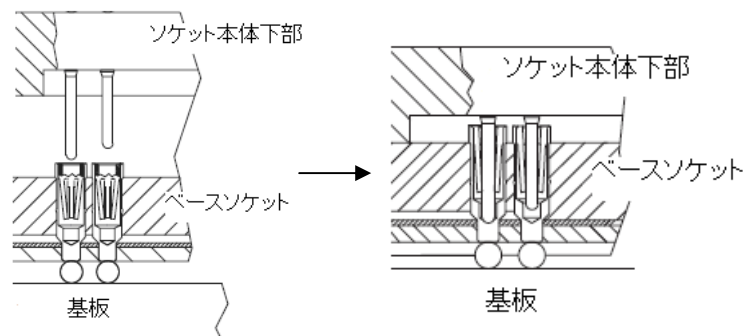
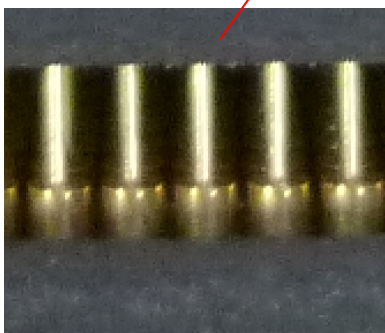
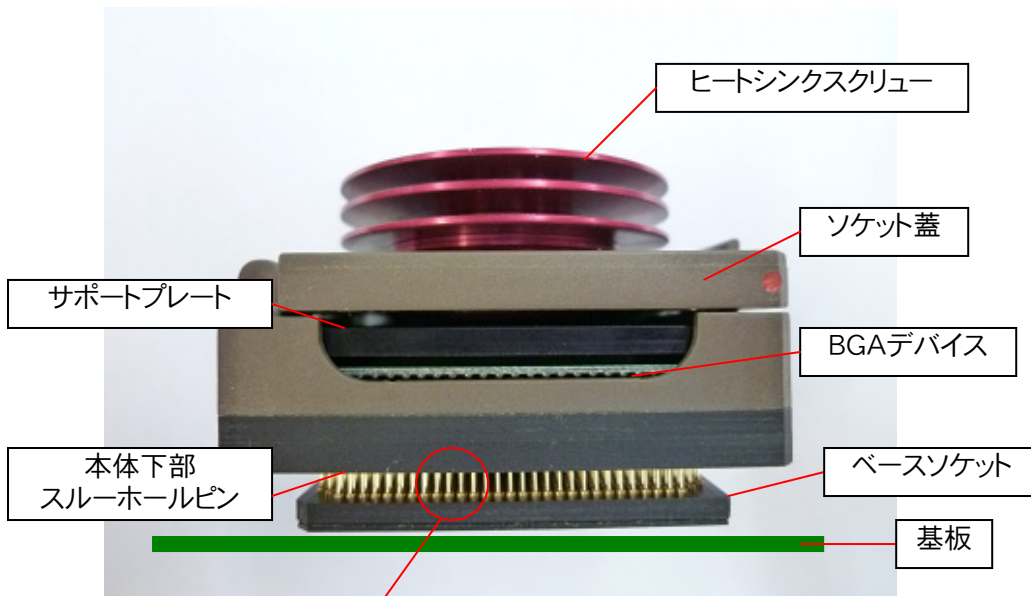


凹みがある方が
デバイス側

蓋を閉めます



側面から見たところ



ベースソケットのサイズはお使いのデバイスのサイズと同じなので、お使いの基板にそのまま実装する事が出来ます。